

5570

SMT ZIF-Stecker RM 0,50mm, liegend SMT ZIF-Connectors, 0.50mm Pitch, Horizontal

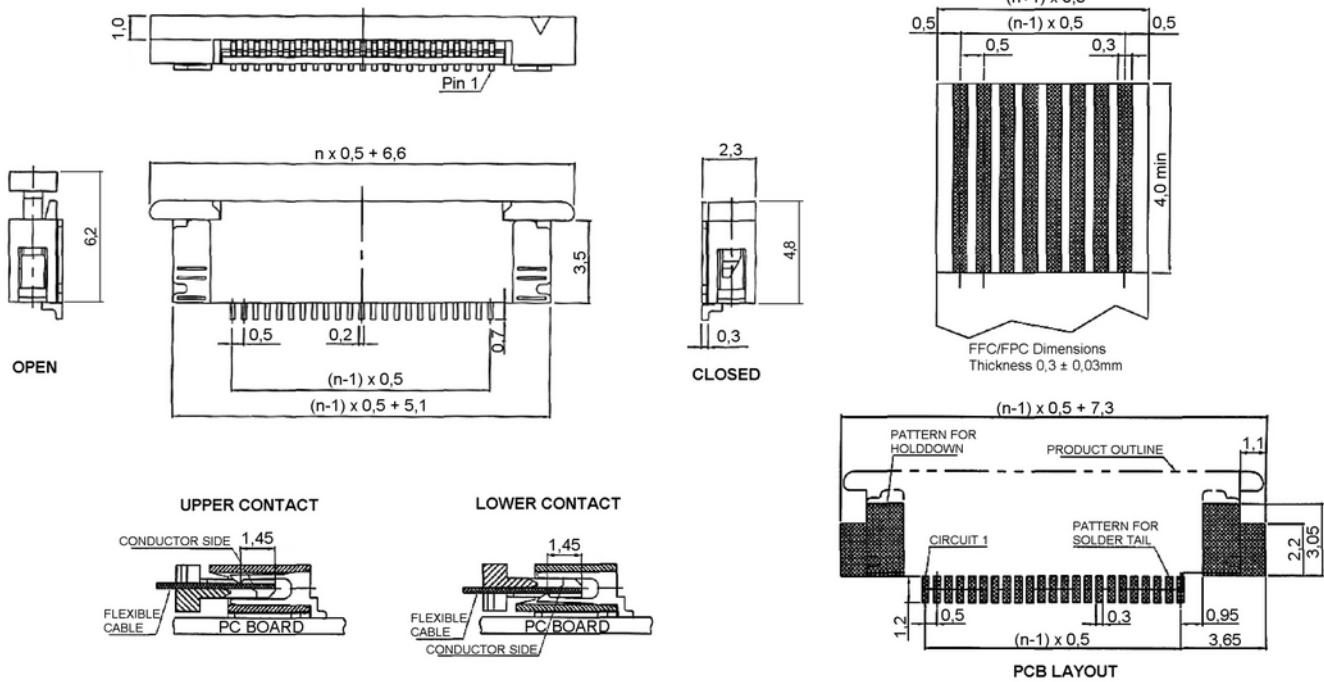
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Zinn über Nickel
Contact Surface	Tin plated over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁸ Ω
Spannungsfestigkeit	250V _{AC}
Test Voltage	250V _{AC}
Nennspannung	50V _{AC}
Voltage Rating	50V _{AC}
Nennstrom	0,5A
Current Rating	0,5A
Temperaturbereich	-20°C ... +85°C
Temperature Range	-20°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Flex-Kabel:
Mate with Flexible Flat Cables:
599



Series	Contacts*	Type*	Packaging*
5570	30 04-60	20 10 Kontakt oben Upper contact 20 Kontakt unten Lower contact	ST ST TR

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad
TR Tape & Reel / Tape & Reel

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
 FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
 WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

